

DB-8002 型 LED 全自动粘片机

DB-8002 型 LED 全自动粘片机是 LED(发光二极管)生产过程中用于将管芯粘接到引线框架上的一种自动化设备,是 LED 生产线上后封装工序必备的关键设备之一。

主要技术特点：

晶片台机构：采用双层直线导轨工作台和滚珠丝杠结构,具有很高的定位精度和重复精度。

点胶机构：采用精密机械结构用于银胶取量控制,点胶头容易更换,应用于不同尺寸的晶片。

顶针机构：偏心轮机构使顶针运行更平稳、柔和,具备快速换针能力。

焊臂机构：独特的四连杆机构确保粘接精度,粘接压力在 40~200g 之间可调。

传输机构：传输参数可进行编程设置,方便产品更换。

图像识别系统：双 CCD 机构可进行芯片识别对准和芯片粘接状况的监控。

上料机构：适合于多种垂直支架。

下料机构：方便、准确地把支架接收到料盒中。

主要技术指标：

粘片机指标：

粘片速度：420 毫秒/粘片循环

粘片精度： $\pm 50 \mu\text{m}$ (XY 定位) θ 精度： $\pm 5^\circ$

芯片尺寸：0.18×0.18mm-1×1mm

吸头：表面拾取型

旋转臂：90° 旋转焊臂

粘接压力：40-200g 可调节

晶片台机构指标：

有效行程：152×152mm

重复精度： $\pm 0.005\text{mm}$

点胶机构指标：

Z 向行程：5mm

重复精度： $\pm 0.01\text{mm}$

Y 向行程：50mm

重复精度： $\pm 0.005\text{mm}$

顶针机构指标：

最大行程：2mm

所需设施：

输入电压： $\sim 220\text{V} \pm 22\text{V}(50\text{Hz})$

整机功率：2KW

气源压力：0.5-0.6MPa

真空： $\leq -700\text{mbar}$

体积及重量：

外形尺寸：1100mm×850mm×1760mm

重量：800kg

